

KAIST IDEC

시스템반도체설계 실무인력양성사업

컨소시엄 기업 소개

(15개사, 2025.02.01 기준)



- 목 차 -

컨소시엄 기업(15개사)

1. 라닉스	1
2. 램칩	3
3. 보스반도체	5
4. 사이언티픽아날로그랩스	7
5. 세미파이브	9
6. 스카이칩스	11
7. 아르고	13
8. 아이언디바이스	15
9. 어보브반도체	17
10. 잇다반도체	19
11. 커넥스트	21
12. 텔레칩스	23
13. 퓨처디자인시스템	25
14. 하이딥	27
15. 해치텍	29





(주) 라닉스



www.ranix.co.kr

『회사소개』

라닉스는 차량용 시스템 반도체를 설계 및 개발하는 기업으로 자율주행자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심 기술인 무선 통신과 보안에 관련된 H/W, S/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화 하는 토탈 핵심 솔루션을 보유한 기업입니다. 2019 년 코스닥 상장을 하였으며, 2021 년에 중국지사를 설립하여 해외 시장의 기회도 넓혀 가고 있습니다.



『주요 사업 및 제품』

주요 사업 분야는 미래 자동차, IoT/국방, 헬스케어 분야가 있습니다. 국내의 고속도로와 유료도로의 통행료 결제 시스템인 ETC (Electronic Toll Collection, 하이패스) 칩 시장의 80%를 차지하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 자율주행 자동차의 필수 요소인 V2X 통신 칩셋 및 보안칩 솔루션, S/W 스택, H/W 솔루션을 보유하여 글로벌에서도 유일하게 토탈 솔루션을 공급하고 있습니다. IoT 산업에 에너지 관리 기술인 스마트미터링 (AMI)에 보안칩을 제공하는 기술력을 바탕으로 양자보안까지 확보하여 국방용 통신용 무전기 및 드론에 보안 솔루션을 공급하고 있습니다.

또한, 라닉스는 다양한 헬스케어 디바이스를 활용하여 실시간 모니터링 및 수집 데이터를 기반으로 자가 건강 관리 솔루션을 제공합니다. 60GHz 의 밀리미터파를 활용한 레이다는 주로 독거노인 혹은 요양원과 같이 체계적인 건강 관리가 필요한 사람을 대상으로 설계되었으며, 심박, 호흡, 낙상 및 다양한 자세를 감지하여, 유사시 관리자 및 보호자에게 알림을 줘서 응급조치를 취할 수 있습니다. 노인층을 위한 팬던트 형식의 단말기인 모바일 개인 응급 대응 시스템 (mPERS, mobile Personal Emergency Response System)을 개발하였으며, 효율적인 운용을 위한 모니터링 시스템도 함께 개발하여 고객사에게 솔루션을 제공하고 있습니다.

주력 제품 / 서비스			
			
ETC 솔루션	V2X 솔루션	차량/IoT/군용 보안 솔루션	헬스케어 레이더

『회사 연혁』

- 2024 년 - 강릉시 자율주행차량용 V2X OBU 납품
- KCMVP 보안수준 3 단계 암호모듈 기술 개발 사업 수주
- 2023 년 - 국내/중국 DSRC SoC(MaaT-VI/THoTH-Ⅲ) 개발
- Hybrid V2X OBU(RXV 200) 개발
- 2022 년 - 고속 V2X 보안 기능을 제공하는 RS2522 제품 개발
- 2021 년 - 보안 암호칩(RS1211) KCMVP 인증 획득
- 중국법인 설립
- 2020 년 - 보안 암호칩(RS2332) KCMVP 2 등급 국내 최초 획득
- 2019 년 - 코스닥 상장
- WAVE V2X 통신 솔루션 출시 (N-WAVE, 3 세대 ASIC 기반)
- 2018 년 - 암호 보안 컨트롤러 상용화(RS2332)
- 하이패스용 DSRC SoC 상용화(MaaT-V)
- 2017 년 - WAVE V2X 통신 솔루션 개발(G-WAVE, 2 세대 ASIC 기반)
- 2016 년 - 중국 ETCS 용 DSRC SoC 개발(MaaT-IV)
- 2015 년 - 하이패스용 DSRC SoC 상용화(MaaT-IV)
- WAVE Modem/MAC 2 차 시제품 개발(S-WAVE)
- IoT 저전력, 경량화 보안칩 개발
- 2014 년 - 모바일 지불결제용 SD Controller 상용화(Astroids Ⅱ)
- 2013 년 - 휴대폰 배터리 인증칩 상용화(RP4301)
- 2012 년 - 금융결제용 Micro SD Controller 상용화
- 2011 년 - WAVE Modem/MAC 1 차 시제품 개발(E-WAVE)
- 2009 년 - INNO-BIZ 기업 선정
- 2007 년 - DVR 용 H.264 코덱 상용화
- 2005 년 - 기업부설연구소 설립
- 2004 년 - DVB-S 용 CAM SoC 상용화
- 벤처기업 인증
- 2003 년 - (주)라닉스 설립

『근무환경 및 복지』

지원금/보험	급여제도	선물	교육/생활
- 경조사 지원	- 퇴직연금	- 명절선물	- 워크숍
- 체력 단련실 운영	- 장기 근속자 포상	- 생일선물	- 점심식사 제공
	- 4 대 보험	- 결혼기념일선물	- 음료 (차,커피)
근무 환경	출퇴근	리프레시	
- 휴게실/수면실/회의실	- 재택근무	- 연차	
- 공기청정기/카페테리아	- 자율근무제,	- 콘도/리조트 이용권	

채용담당자: 김하윤 pro / 02-584-5516(416)/ recruit@ranix.co.kr



(주) 램칩

www.ramschip.com

ram-sCHIP
F N A L O G I X E D I G N A L

“Wielding technology to design super-fast SERDES”

램칩은

고속 인터페이스 IP 에 특화된 전문성을 갖고 있는 반도체 설계 IP 기업입니다. 우리는 선을 타고 흐르는 데이터의 이동이 어느 표어처럼 보다 빠르게, 보다 멀리, 보다 안정적으로 가능하도록 하는 회로 기술을 개발하고 있습니다. 이를 위해서 진보된 설계 흐름을 함께 마련하여 보다 영리하게 문제를 해결하려고 합니다. 램칩은 경쟁력 있는 IP 를 공급하기 위해 최첨단의 아날로그 회로 설계 기법, 신뢰할 수 있는 디지털 로직 구현은 물론 안정적인 고속 전송을 위한 신호 처리 알고리즘과 최적화 문제를 풀기 위한 소프트웨어적 접근을 포함하는 폭넓은 연구 활동을 수행합니다.

2021 년에 세워진 램칩은

최고의 기술 회사를 목표로 풍부한 경력과 전문성을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

- ▷ 2021. 1 – 법인 설립
- ▷ 2021. 3 – 시스템 반도체 설계지원센터 입주
- ▷ 2021. 6 – 벤처 기업 인증
- ▷ 2021. 10 – 기업 부설 연구소 설립
- ▷ 2022. 1 – 삼성 파운드리 협력사 시스템 구축
- ▷ 2022. 2 – SEED 투자 유치
- ▷ 2022. 3 – BIG3 혁신분야 창업패키지 지원 사업 선정
- ▷ 2022. 4 – 시스템반도체 핵심 IP 개발 사업 주관기관 선정

현재, 램칩은

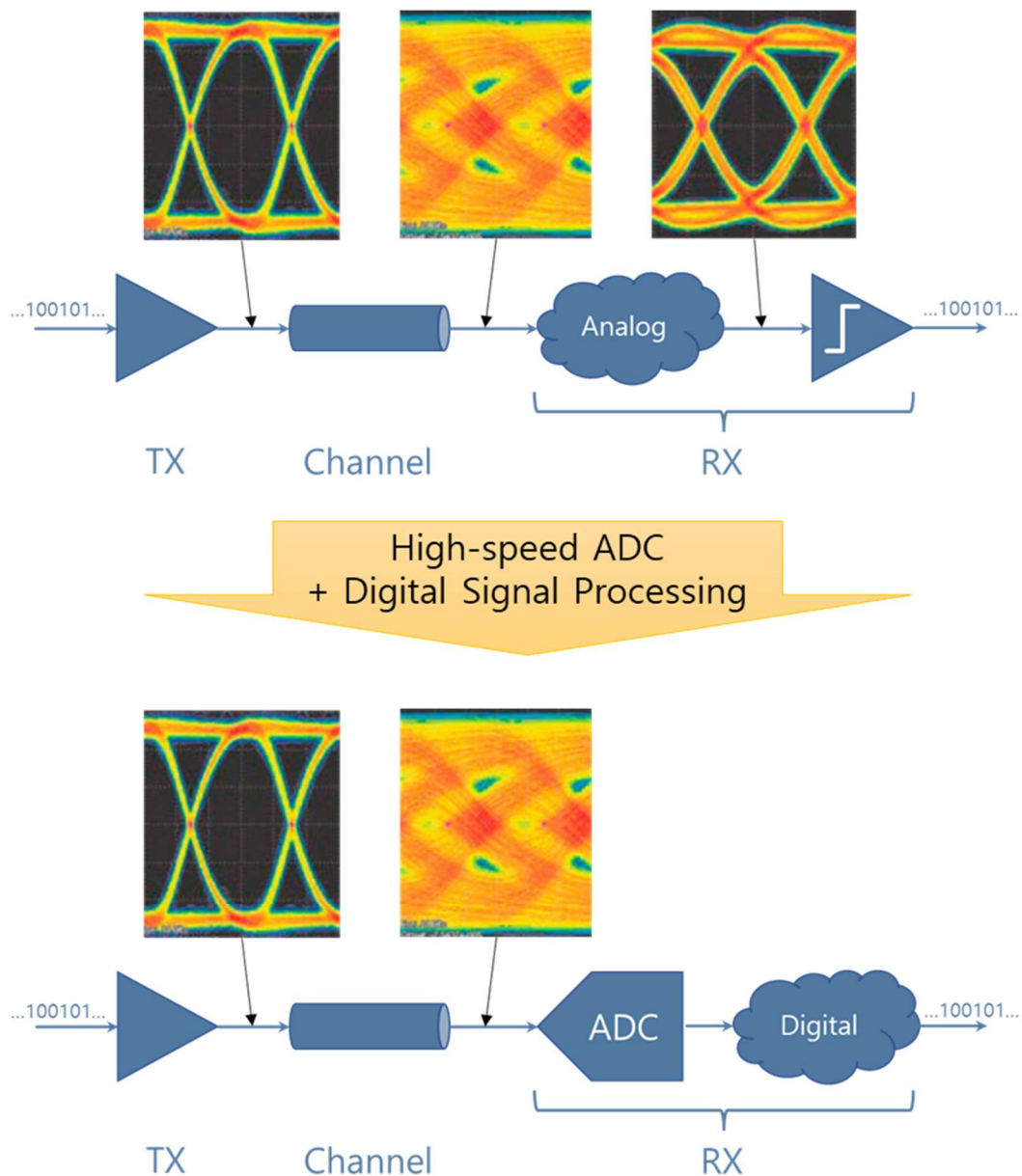
다가올 자율주행 기술과 날로 발전하는 지능형 운전자 보조 시스템(Advanced Driver Assistance System)에 필수적인 이미지 데이터 전송을 위한 고속 인터페이스 IP 를 준비합니다. 이와 관련된 국제 표준인 MIPI A-PHY 와 ASA MotionLink 에 대응하는 회로 기술을 확보하여 차량용 반도체 시장에 진출하려고 합니다.

또한, 삼성 파운드리와 Sublicensing 파트너사로 국내외 수요기업에게 5nm 이하부터 시작하는 초미세 FinFET 공정을 포함하여 다양한 공정 노드에서 MIPI D-PHY/C-PHY, ARM HSSTP IP 등의 SoC 용 IP 를 공급하는 사업 모델을 갖고 있습니다. 삼성 파운드리와 맺어진

긴밀한 협력 관계와 램쉽의 설계 기술이 더해져서, 스타트업으로서 기대할 수 있는 가장 빠른 성장 속도로 반도체 설계 업계에 자리 매김할 것입니다.

핵심 보유 기술은

채널을 통과하며 왜곡된 고속의 전송 신호를 복원하고, 타이밍을 추출하여 원래의 값으로 수신하는 회로 설계 기술입니다. 특히, 전통적으로 사용되는 아날로그 영역에서의 데이터 처리 기술은 물론, 최근 각광받고 있는 고속의 ADC(Analog-to-Digital Converter)와 DSP를 기반으로 하는 인터페이스 회로 기술을 보유하고 있습니다.



※ 채용담당자 : 임종혁 팀장/ 010-7232-7822/ jhlim@ramschip.com



(주)보스반도체



www.bos-semi.com

BOS, Driving the Future of Automotive!

회사명	(주)보스반도체
대표	박재홍
주소	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24, 3층
홈피	www.bos-semi.com (2) BOS Semiconductors: 회사 LinkedIn
채용담당자	서경미/msgyeongmi@bos-semi.com/010-2276-9786
BOS 연혁	- 2022년 5월, 창업 (성남시 판교벤처벨리) - 2022년 8월, 현대자동차 시드투자 유치 - 2022년 9월, 벤처기업 인증 - 2022년 11월, BHRC (BOS Ho Chi Minh R&D Center) 오픈 운영 중 - 2023년 1월, 기업부설연구소 인정 - 2023년 5월, PreA SAFE 투자 유치
회사 소개	(주)보스반도체는 "Leading Mobility Innovation with Semiconductor Technology"를 비전으로 세계 최고 수준의 실력을 인정받은 CEO, CTO, 그리고 각 팀 리더분들이 주축이 되어 차량용 자율주행 SOC, Mega MCU, Gateway SOC 등 반도체 및 소프트웨어를 포함하는 Total Solution을 제공하는 차량용시스템반도체 개발 전문 스타트업입니다. 2022년 5월 판교에 설립되었으며, 국내는 물론 세계 유수 기업들과 경쟁할 수 있는 세계 수준의 팹리스를 목표로 하고 있습니다.

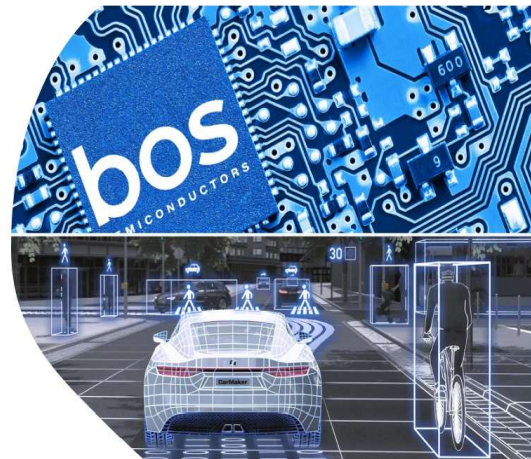
핵심 경쟁력

- **전문가 그룹**: SoC 설계, 개발 및 생산까지 전체 프로세스를 경험한 업계 최고의 전문가 그룹이 설계부터 생산까지 함께하여 글로벌 경쟁력을 높일 수 있습니다.
- **기술역량**: 우수한 Reconfigurable Scalable 반도체 Platform, 설계 및 소프트웨어 핵심기술력을 기반으로 고객의 니즈에 특화된 우수한 차량용 반도체 개발을 가장 효율적인 방법으로 가능하게 합니다.
- **반도체 밸류 체인 협업**: 전문가 리더 그룹이 개발 및 양산 경험으로 다져온 다양한 파트너사와의 네트워크 활용을 통한 원활한 협업으로 최고의 가치를 창출 할 수 있습니다

- **전략적 파트너십:** BOS 반도체는 현대자동차그룹의 차량용 고성능 SoC 분야 유일한 전략적 파트너십으로 현대자동차그룹 제품의 로드맵을 공유하고 있습니다.

*2023 년 9 월 BOS 첫 프로젝트(NPU Accelerator SoC) 수주.

*미래자동차 혁신방향 AD, HPC, Gateway 및 Super SoC 제품 개발/ UAM, 로봇 등 미래 모빌리티 분야로 제품군을 확장해 나가도록 계획하고 있습니다.



목표 제품: 자동차 반도체

AD SOC

•자율 주행 SOC CPU, GPU, NPU, Camera신호 처리 등 기능

HPC

•Zonal 아키텍처 기반 Mega MCU
•파워트레인, 인포테인먼트, Body & Comfort, ADAS, 커넥티비티 등
도메인별 기능을 하나의 HPC에 통합하고 가상화를 통하여 SW로 구현

•ISP, DSP, GPU 등 특정 도메인용 액셀러레이터 기능

Gateway

•자동차 네트워크내 데이터 라우터 및 도메인별 컴퓨팅 유닛 기능

•Ethernet, CAN, LIN 등

•Security 및 Offloading

Super SOC

•자동차내 AD, HPC 등 모든 기능을 통합하여 하나의 SOC에서 SW로 기능 구현

사업화 제품



NPU Accelerator



HPC



AD SOC



Gateway SOC



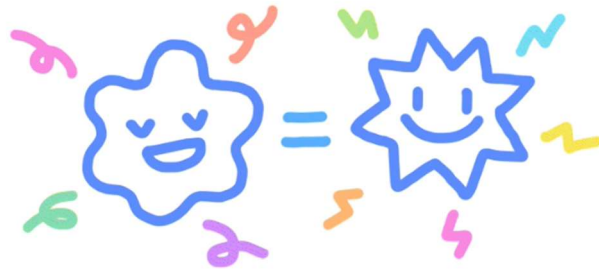
Super SOC

회사 소개 영상:

BOS semiconductors ~ Driving the Future of Automotive!

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7140146846189895680>

안녕하세요, 사이언티픽아날로그랩스 입니다.



Make Analog IC Design as Systematic and Productive as Digital

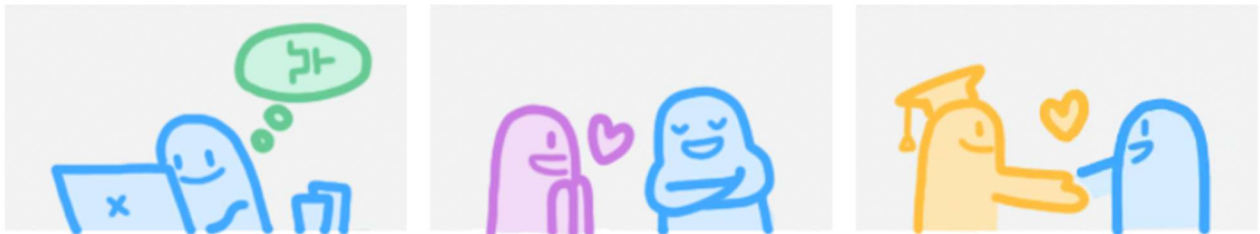
사이언티픽아날로그랩스는 아날로그 IC도 디지털 IC처럼 쉽고 체계적인 방법으로 설계할 수 있다는 신념을 가지고 설립한 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 Scientific Analog의 한국법인입니다. 서울시 서초구 남부터미널역 근처에 위치하고 있습니다.

오늘날 설계되는 시스템-온-칩(SoC)들은 그 회로의 대부분이 디지털 회로로 구성되어 있기에 검증 또한 디지털 환경에서 수행되고 있지만, 필수적으로 함께 포함되는 아날로그 회로들 때문에 칩 전체의 검증을 하는데 어려움이 많고, 뒤늦게 발견한 사소한 오류 때문에 개발한 제품의 시장 진입이 지연되는 경우가 많습니다.

Scientific Analog는 바로 이러한 문제를 해결하기 위해서, 아날로그 회로들을 기존의 디지털 검증환경 상에서 모델링하고 시뮬레이션할 수 있는 EDA 소프트웨어 툴인 **XMODEL**, **GLISTER**, **MODELZEN**을 개발하였습니다. 그리고 이들을 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 다수의 반도체 설계 회사들에서 실제 제품 검증에 활발히 사용 중입니다.



- **XMODEL:** 디지털과 아날로그 회로가 섞여있는 SoC 검증을 효과적으로 수행할 수 있도록, 기존의 디지털 검증환경인 SystemVerilog 상에서 아날로그 회로의 모델을 빠르고 정확하게 시뮬레이션할 수 있게 해주는 확장솔루션입니다.
- **GLISTER:** SystemVerilog 코딩에 익숙하지 않은 아날로그 설계자들도 보다 친숙한 환경인 Cadence Virtuoso 환경에서 아날로그 회로의 모델들을 schematic 형태로 쉽게 작성하고, 시뮬레이션을 수행할 수 있게 해주는 GUI 환경입니다.
- **MODELZEN:** 이미 설계가 완료된 아날로그 회로로부터 SystemVerilog 모델을 자동으로 생성하여, SPICE보다 10배 이상 빠른 시뮬레이션을 디지털 검증환경에서 수행할 수 있게 해주는 모델생성툴입니다.



사이언티픽아날로그랩스에서는 IC 설계자와 검증자들이 XMODEL, GLISTER, MODELZEN을 효과적으로 사용할 수 있도록, **다양한 아날로그/혼성신호 회로의 모델 예제들을 개발**하고, 그 경험을 바탕으로 **국내외 고객사에 전문적인 기술지원을 제공**할 수 있는 **아날로그/혼성신호 모델개발자**를 상시 모집중입니다.

아날로그/혼성신호 모델개발자가 되면, IC 설계 경험이 풍부하지 않아도, 다양한 회로 분야에서의 전문성을 단기간에 키우면서, 아날로그/혼성신호 검증이라는 떠오르는 분야의 글로벌 스페셜리스트가 될 수 있습니다.

- 최신 업계 표준 및 저명 학술 논문들을 읽고, 다양한 아날로그/혼성신호 회로들의 모델들을 개발하면서 전문지식을 쌓을 수 있습니다.
- 국내 대기업들의 설계 및 검증 엔지니어들과 소통하면서 차세대 제품들에 적용된 설계 기술들의 효과적 검증을 위한 방법을 함께 고민할 수 있습니다.
- 국내 명문 대학 연구실들과 협력하면서 IC 설계분야의 교수, 석박사 연구원들과 인적 네트워크를 쌓을 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 웹페이지 www.scianalog.com/careers 를 참고해주세요.

※ 채용담당자 : 황민하 팀장/ 070-7847-9524/ careers@scianalog.com



(주)세미파이브

SEMI FIVE

www.semifive.com

“고객들이 원하는 SoC 를 빠르고 쉽게
제작할 수 있도록 도와주는 플랫폼 제공”

회사 소개

세미파이브는 더욱 효율적으로 시스템 반도체를 설계할 수 있는 반도체 개발 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 오픈 테크놀로지와 독자적인 개발 방법론을 기반으로 반도체 개발에 필요한 비용과 시간을 단축함으로써, 앞으로 더욱 더 다양하고 혁신적인 시스템 반도체가 만들어질 수 있는 기반을 만들어 가고 있습니다.

사업 정보

세미파이브는 설립 3 년여만에 총 1700 여억원에 달하는 3 차례의 투자를 유치하며 인력과 사업 규모면에서 빠르게 성장하고 있습니다. 삼성전자 파운드리 DSP 인 세술반도체와 하나텍을 인수하며 인력 확충 및 대규모 성장을 하였고, 미국 IP 회사인 Analog Bits 를 인수하며 사업 ecosystem 을 공고히 하였습니다. 2022 년에는 삼성전자 파운드리 DSP 지위를 득하며 삼성전자와 밀접한 협력 관계를 구축하였으며, 국내외 대기업들과 파트너십 체결 및 개발 계약을 체결하며 입지를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 미국, 인도, 베트남 등 해외에 연구소 및 영업지사를 운영하며 적극적으로 글로벌 고객 및 인력을 확보하고 있습니다. 당사 플랫폼을 통해 개발되는 첫 제품은 2021 하반기 중 성공적으로 출시하였고, 2022 하반기 중 첫 양산에 돌입할 예정입니다.

회사 제품 설명

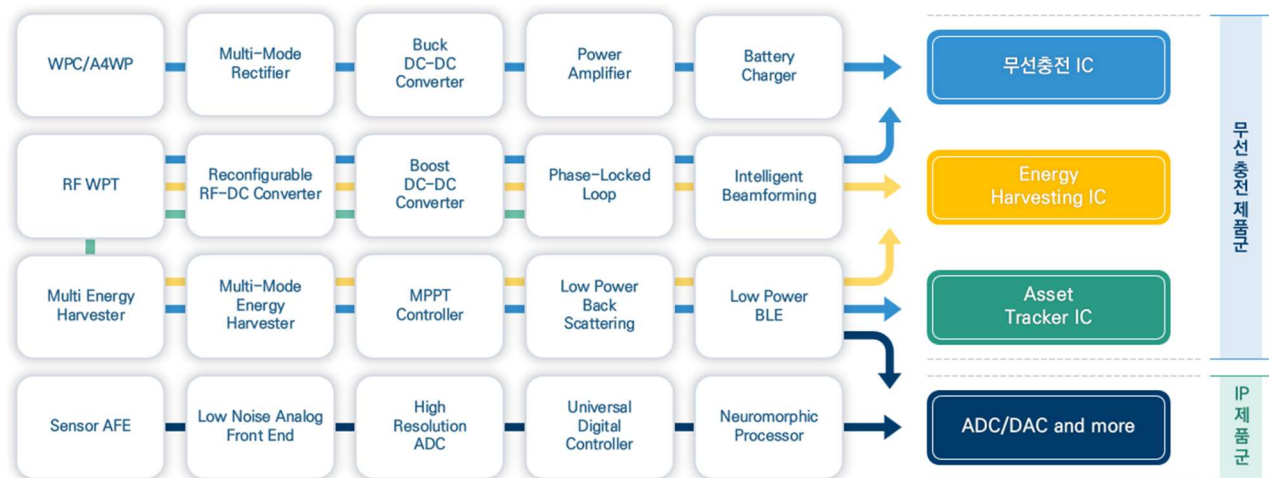
세미파이브는 Domain-specific SoC Architecture 를 통해 특정 응용처에 최적화된 Template 을 구현하고 재사용률을 극대화 하여 고객들이 원하는 SoC 를 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 도와주는 플랫폼을 제공합니다.

핵심 보유기술 설명

기존 반도체 개발 방식은 IP 소싱부터 시작하여, POC(proof of concept), 검증, 설계, 프로토타입 제작까지 무수히 많은 프로세스를 직접 진행하며 최소 수 십억 원의 비용과 1~2 년의 개발 기간이 필요하지만, 세미파이브 디자인 플랫폼의 경우 이 프로세스의 상당 부분을 자동화하고, 다양한 분야에 재사용이 가능한 최적화 및 검증이 완료된 Template 을 기반으로 반도체 개발에 필요한 비용과 시간을 대폭 줄여줄 수 있어 더 많은 반도체 개발을 유도할 수 있습니다. 따라서, 고객들은 당사 응용처별 플랫폼에 자신들이 보유한 핵심 IP 와 Software 만 탑재하면 기존 방식 대비 훨씬 빠르고 쉽게 SoC 를 확보할 수 있게 됩니다. 현재는 아래와 같이 AI Inference 플랫폼과 AIoT 플랫폼을 개발하여 상용화 프로젝트를 완료 및 진행 중이며, AI Inference 플랫폼을 재사용하여 기간과 비용을 대폭 단축한 상용화 프로젝트 또한 2022 년 말 완료될 예정입니다. 또한, HPC 향 5nm 플랫폼을 이용한 상용화 프로젝트도 개발 진행 중이며, 향후 보다 더 많은 응용처향으로 플랫폼 포트폴리오를 확장시켜 나갈 것입니다.

채용담당자 : 송정진/ 010-8290-1490/ Jeongjin.song@semifive.com

스카이칩스는 성균관대 IC lab 기반의 연구실 창업회사로, 10 여년간의 연구 및 기업체/국책 과제를 통해 개발한 많은 IP 를 바탕으로 2019 년에 창립되었습니다. 2021 년까지는 기업체 과제/국책과제를 주요하게 수행했으며, 그 동안 축적된 IP 를 기반으로 자체 제품 출시를 위해 개발을 진행하고 있습니다. 2020 년에 초기창업패키지 프로그램을 최우수로 마쳤고, 현재는 TIPS 에 선정되어 과제를 진행하고 있습니다.



스카이칩스는 AI 를 활용한 근거리·원거리 무선충전기술을 개발하는 팹리스 기업입니다. 무선 전력 전송 기술을 연구하는 팹리스 기업은 해외에도 많이 있으나 여기에 뉴로모픽 (Neuromorphic) AI 기술을 결합한 건 스카이칩스가 세계 최초입니다.

현 시점에는 접촉해야만 충전 가능한 무선충전 기술이 상용화되어 있지만 스카이칩스가 개발하고 있는 제품은 접촉 비접촉 상관없이 AI 가 스스로 파악해 멀리 있는 전자제품에도 무선주파수를 통해 전력을 전송해 줄 수 있는 시스템입니다.

근거리·원거리를 동시에 지원하는 무선충전기술 개발에 핵심이 되는 IP 들의 개발이 진척되어 현재 파운드리를 통해 제작 중에 있으며, 이에 대한 성능 검증 후 2023 년도에 본격적으로 양산에 돌입할 준비를 진행하고 있습니다.

이와 더불어 스카이칩스는 국내 굴지의 기업으로부터 자산/물류 관리에 사용되는 IC 에 대한 개발 의뢰를 받아 성공적으로 개발 진행중에 있으며, 고객사의 물량 예측에 기반하여 2023 년 초부터 많은 물량을 공급할 계획을 가지고 있습니다. 이 제품은 고객사의 제품 아이디어와 스카이칩스의 기술력을 합쳐 기획되었으며, 기존 제품의 한계로 인해 시장확대가 되고 있지 못한 자산/물류/재고 관리 시장에 획기적인 솔루션이 될 것입니다.

그리고 무선충전 및 관련 기술력을 인정 받아 series A 투자를 2022 년 상반기에 성공리에 마무리했으며, 또한 상장주관사로 삼성증권과 계약을 맺고 2024 년을 목표로 상장 준비에 들어갔습니다. 또한 2022 년 8 월에 삼성전자와 중소벤처기업부가 주관한 팹리스 챌린지 대회에 선정되었습니다.

신문기사에 실렸던 스카이칩스 이강윤 대표이사의 인터뷰입니다.

“하나의 전공에만 국한되지 않고 넓은 시야로 세상을 바라볼 수 있다는 것이 스카이칩스의 가장 큰 장점이라고 생각합니다. 때문에 스카이칩스 구성원들 또한 주체적이고 능동적으로 연구를 하면서 자신의 역량을 키워 나가고 있고요. 저 또한 연구와 사업을 병행하면서 남들보다 한발 더 앞서 나가는 연구를 하려고 노력하고 있습니다. 때로는 도전에 실패하더라도 다시 보완하여 도전할 수 있다는 점이 산학을 아우르는 스카이칩스의 장점이라고 생각합니다. 기업은 어찌됐던 이익을 추구해야 하기 때문에 실패 이후에는 다른 사업을 모색해야 하지만 스카이칩스에서는 이익을 낼 수 있는 안정된 제품군 개발은 물론, 실험적이고 도전적인 연구들도 함께 수행하고 있습니다. 시스템 반도체 분야에 대해 도전적이고 창의적인 인재들이 스카이칩스로 모였으면 하는 바람입니다.”



(주) 아르고



www.argosys.co.kr(URL)

회사 소개

Overview

설립연도

2009년 7월

대표이사

박준규

회사위치

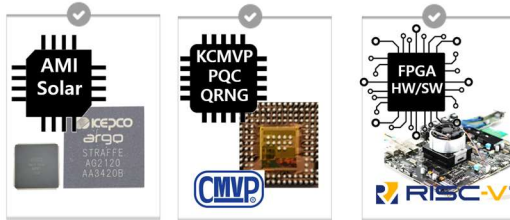
경기도 수원시 영통구 광고중앙로

인원

30명

제품군

스마트에너지 및 보안 SoC, SoCaaS



양산 및 개발 중인 제품 군

회사 비전

Vision

1. Smart Energy : Smart Grid, Electricity, Smart Solar

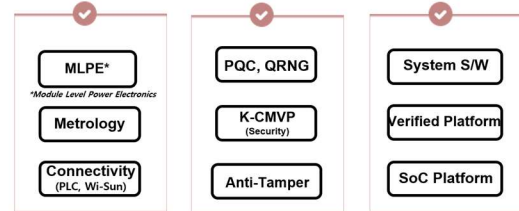
스마트에너지 및 그리드 반도체 업체

2. Smart Security : KCMVP, QRNG, PQC

스마트 보안 시스템 반도체 업체

3. SoC as a Service (SoCaaS) : RISC-V, FPGA, AI

시스템반도체용 HW/SW 플랫폼 서비스업체



확보된 기술을 바탕으로 신제품 출시

회사소개



스마트 에너지 반도체 및 다수 프로젝트 진행 경험 및 반도체 양산

- 한국전력과 국내 최초 AMI metering SoC 양산
- 디지털 미터 및 전기자 충전 전력량계용 SoC 양산
- 태양광 셀용 MLPE 및 PLC 통신용 SoC 개발



〈Smart Solar용 SoC〉



〈한국전력 Smart Metering SoC〉

Smart Energy
반도체 개발과 양산



에이디테크놀로지
(에이디테크놀로지 국내 최대 반도체 설계 서비스 회사
삼성전자 반도체 설계 파트너)

매출 1000억 (23년) / 대표이사: 박준규 / 임직원: 약 500명

모회사 지원 및 투자
안정적, 지속 가능한
사업전개



〈수원 광고 본사 건물〉



스마트 시큐리티 반도체 양산

- 국내 1호 하이브리드 KCMVP(국정원 암호모듈) 인증 획득
- SKT 向 QRNG(양자암호반도체) 보드 개발 양산
- 서버/보안용 보안 반도체 양산 및 Top 국가 기관에 납품



〈양자암호모듈 및 통신 예시〉



〈국내 1호 하이브리드
KCMVP 획득〉



Smart Security
반도체 개발과 양산

SoC as a Service
HW/SW

SoC as a Service HW 및 SW 개발

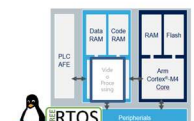
- 세계 최대 크기 AI FPGA Platform 보드 국내 최초 양산 및 판매
- RISC-V / ARM CPU 용 RTOS 및 Linux 기반 Platform 설계 서비스
- RGB/DVS 카메라 기반 신호처리 및 각종 보드 제작



〈차량용 카메라 모듈〉

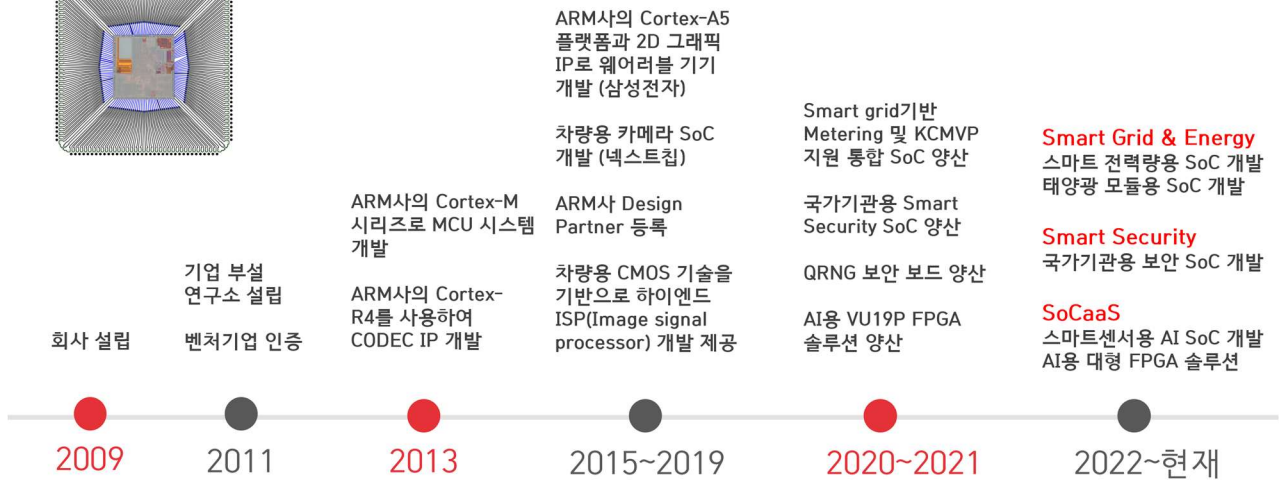
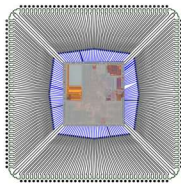


〈AI FPGA Platform〉



〈Camera 기반 SoC Platform〉

회사 연혁



회사 역량



01 팹리스 + 디자인서비스



02 ADTechnology사와 협력



03 핵심 IP 내재화/보안 IP 경험



채용담당자 : 박미경 매니저/ 031-214-0607/ pmkjjh@argosys.co.kr

Analog-Digital-Power in a SingleSilicon™ with valued Software solution

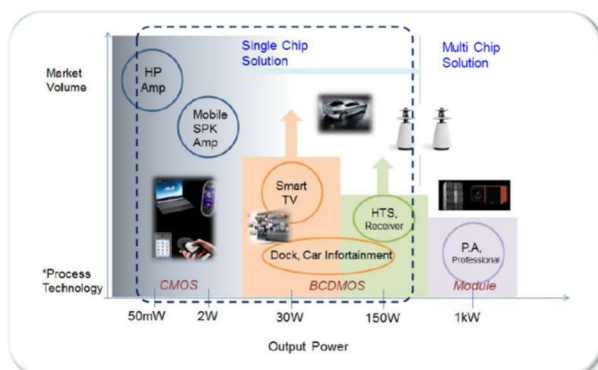
- Business Field : System Semiconductor
- Main Product : Audio/Power Semiconductor

Info.

Official Name	Iron Device Corporation
Established in	May 7, 2008
Founder/CEO	Ki-Tae Park
Address	14F, J-Tower, 139 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06036
Employee	44
Main Product	Focusing on Digital/Power-Mixed SoC

Unified Audio Solution Provider for Smart Devices – a Fabless Semiconductor Company

- Driving from low power earphones to powerful loudspeakers
- High-fidelity data conversion and signal processing
- Using Bipolar-CMOS-DMOS Process/Circuit Technology
- Established in 2008
- Found by the team from Samsung System-LSI
- Has been designed high-end audio chipsets for [Bang & Olufsen] ICEpower since 2004
- Mass production history – shipped over 200Mpcs
- Now, in *Silicon Mitus* Family
- A mixed-signal semiconductor company, providing leading-edge digital/analog/power-mixed single silicon device solution.
- In-house high-performance Audio IP Portfolio
- Not only Rx (Playback) but also Tx (Record) Solution



Analog-Digital-Power
in a **SingleSilicon™**
with valued software solution

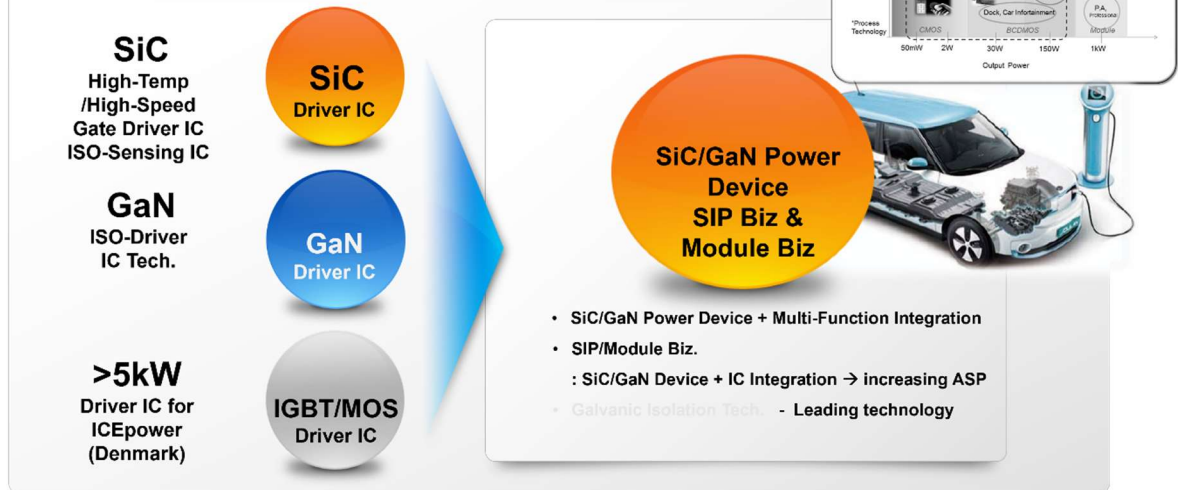
Product Portfolio



Advanced R&D

Long-Term R&D of Advanced Power Semiconductor IP

Since 2016, SiC and GaN Device Driver IP/Product has been developed



채용담당자 : 윤 정 부장/ 010-8898-2218/ jyoona@ironddevice.com

어보브반도체는 “고객중심의 도전과 혁신”이라는 경영이념을 바탕으로

2006 년 매그나칩반도체(구:하이닉스)로부터 독립한 전문 반도체 기업입니다.

어보브반도체의 MCU(Micro Controller Unit) 기술을 기반으로 하여 Sensor, Connectivity 가 융합된 솔루션은 5G 시대 도래에 따른 AI(인공지능), IoT 기술의 혁신과 함께 디지털 세상을 견인하고 있습니다.

어보브반도체는 고객을 위한 끊임없는 도전과 기술 혁신으로 새로운 시장을 창출하는 성과를 만들어 왔습니다. 또한 파운드리 - 팹리스 협력 모델을 국내에 성공적으로 정착시키는 동시에 학계, 산업계와 함께 상생하는 생태계를 만들어 나가고 있습니다.

이제 어보브반도체는 Sensor 와 Connectivity 로 연결되는 Smart MCU 시장의 혁신 주역으로서 고객에게 끊임없는 가치를 제공하며 글로벌 MCU 리더로 성장하겠습니다.

01 Who We Are: ABOV

ABOV는 축적된 기술과 경험으로 지속 성장한 국내 No.1 MCU 회사

40년 가까운 역사, 200개 이상의 제품 개발, 70억개 이상의 제품 판매 경험

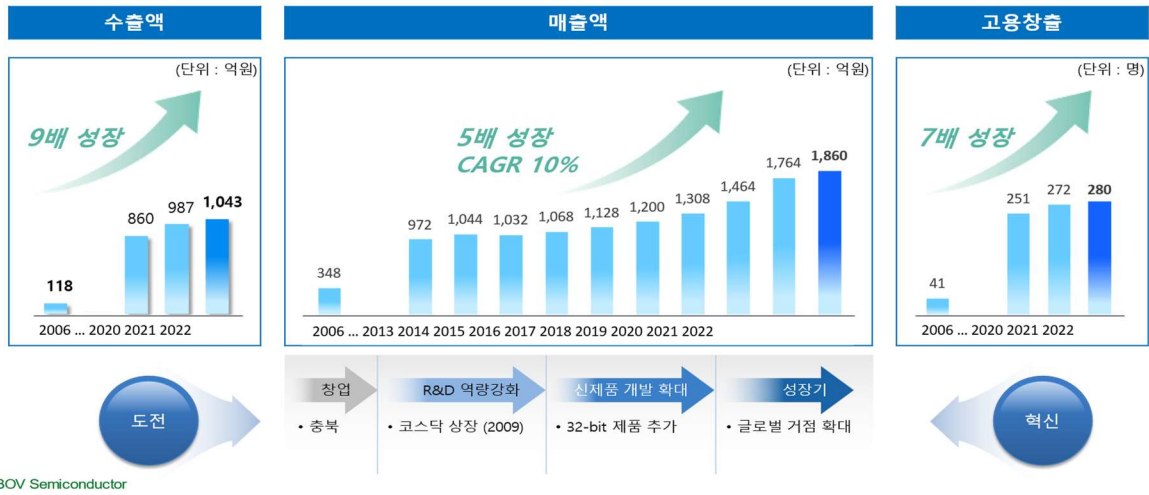
연혁 및 비전



Prologue ③

04 주요 경영지표 성과

기술혁신 및 수출 확대를 통해 반도체 시장 선도
도전과 혁신으로 창업이후 매출 5배 성장, 수출 9배 성장, 고용 7배 성장



Leader of Microcontroller Technology A Fabless Semiconductor Company

복리후생제도

임직원의 생활안정을 도모하고 나아가 복지증진을 통한 임직원 삶의 질 향상을 추구



유연한 근무시간

자율근무제를 통해 Work & Life 모두 효율적으로 집중할 수 있도록 지원



성과보상제도

경영성과급 회사성과에 따른 인센티브 지급



의료비 지원

본인, 배우자, 자녀, 부모님의 질병 및 상해 의료비 지원



장학제도 운영

학위 취득 지원 (학사, 석사, 박사)



해외어학연수

해외어학연수 기회 제공



자기개발 지원

외국어 학습 지원, 어학시험비 지원
사내 도서관 운영



포상제도

기술 개발 장려를 위한 특허 출원 및 등록 포상
칭찬하는 문화 확산을 위한
핵심가치 우수 실천사례포상



하계 휴가

일과 삶의 균형을 위한 법정 연차휴가 이외에
하계휴가(4일) 제공



(주) 잇다반도체



www.itdasemi.com

◆ 설립 사유

삼성전자 출신의 개발자들이 설립한 회사로써, META, GOOGLE, TESLA 등 빅테크 업체와의 협업 경험을 바탕으로, 세계적인 수준의 IP 를 만들 수 있다는 자신감으로 설립한 회사. 유사한 IP 를 개발하는 회사는 세계최고의 IP 회사인 ARM 으로 PCK-600 이라는 IP 를 개발 중이지만, 7 년째 상용화하고 있지 못한 시스템 IP 임. 이를 먼저 개발해서 전세계 선 공급하는 것을 목적으로 함.

◆ 회사 개요

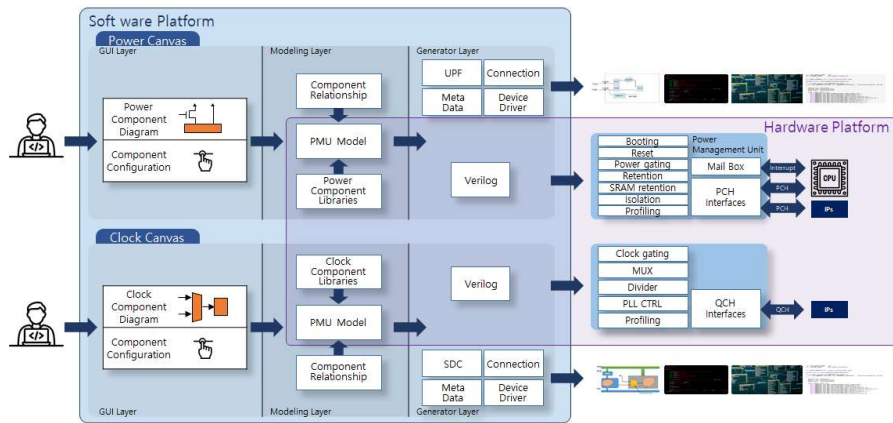
회사는 설립 이후 2~3 개월 마다 꾸준히 새로운 실적을 만들고 있는 회사. 개발자 3 명이 설립한 회사이기 때문에, 엔지니어 친화적인 회사로, 엔지니어링의 퀄리티를 회사의 가장 중요한 요소로 생각함.

- 2022.09 창업
- 2022.12 카이스트 창업어워드 대상
- 2023.03 보스반도체 공급 계약
- 2023.04 초기 창업 패키지 선정
- 2023.05 디딤돌 과제 선정
- 2023.07 블루포인트, 포스텍 홀딩스, KOC 파트너스로부터 시드 투자 완료
- **Future with you**

2022 년 9 월 창업 이후, 카이스트 창업 어워드 대상, 정부 지원 및 정부 과제 등을 규모에 맞게 진행하고 있으며, 7 월에 시드 투자를 완료함. 시드 투자의 경우 동시에 3 개사가 참여할 정도로 높은 관심을 받았음. 이 후 후속 라운드 진행 관련해서도 다수의 투자사가 관심을 보이는 중.

◆ 사업 아이템

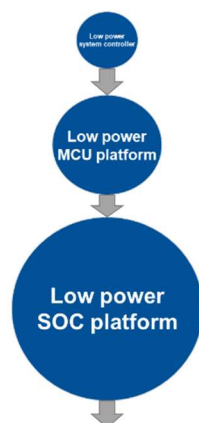
- 반도체 파워/클럭 구조 설계를 low code형태로 진행할 수 있는 반도체 IP 및 플랫폼 소프트웨어 개발 중. 아래 그림의 하드웨어 프레임워크를 소프트웨어 프레임워크를 통해서 매우 손쉽게 생성할 수 있음. 하드웨어와 소프트웨어의 동시 개발로 생성형 IP에 해당하기 때문에, 높은 기술 수준을 필요로 함.



<개요 - 잇다반도체의 Low code 파워 시스템 설계 플랫폼 개념도>

▶ 잇다반도체는 기존 시장에서는 개발하지 못하는 형태의 반도체 IP 및 이를 low code형태로 설계가 가능하게 하는 차별화된 소프트웨어 기술력을 보유함. 이러한 차별화된 기술력을 바탕으로, 반도체 파워/클럭 시스템 솔루션을 발전 시켜서, 전체 반도체 시스템 설계의 자동화를 하는 것을 목표로 함. 반도체 내의 다양한 자동화 솔루션을 개발해서, 팹리스 업체의 부족한 기술력 등을 보충할 수 있는 형태의 솔루션을 개발할 계획.

◆ 회사의 비전



반도체 설계를 위한 필수 플랫폼 회사

- 1 차적으로는 차별화된 하드웨어 개발 능력과 소프트웨어 개발 능력을 합쳐서, 전세계 시스템 반도체 제작의 필수 플랫폼이 되는 것을 목표로 진행 함.

- 장기적으로는 이러한 기술력을 바탕으로, 자체 제작 SOC, PMIC 등 칩 시장의 진출도 진행해서, 최종적으로는 종합 반도체 기업이 되는 것을 목표로 함

채용담당자 : 전호연 대표/ 010-9211-0639/ hoyeon@itdasemi.com



(주) 커넥스트



www.conextt.com

Conextt Inc.

Our company provides IOT/Automotive Semiconductor manufacturing solutions.

1. Company Overview

Company Name	Conextt Inc.
Founded	2015.08.04
CEO	Hong Jong Wook
Business Portfolio	Semiconductor Design/Verification Service
Location	Office 1 : Nongseo-dong T-10053,11, SeoCheon-ro 201beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do Office 2 : 2th Floor, 28, Mabang-ro Seocho-gu, Seoul (RBS)
Contact	070-4211-8996
Employees	32

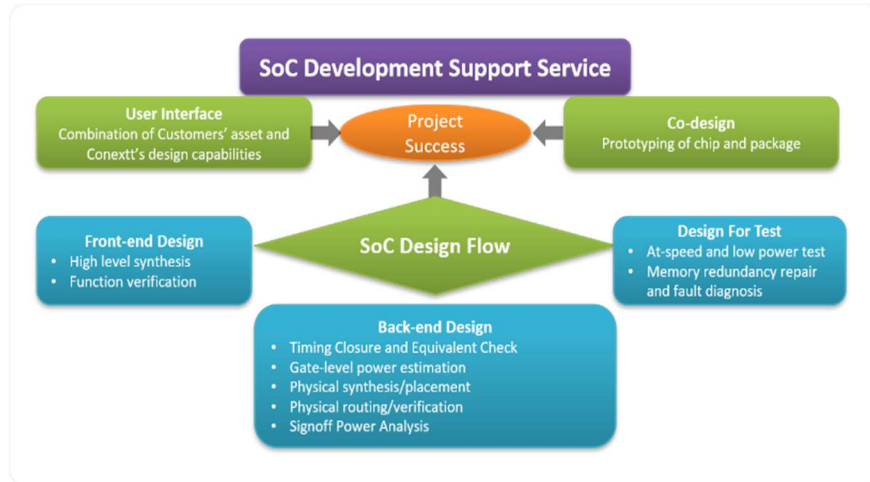
2. Company History

- 2015.08 : Conextt Inc. was founded
- 2015.12 : Won a KSIA* Project of Semiconductor IP Verification and Commercialization
- 2016.06 : Won a ICT Future Tech Project of MoSIF**
- 2016.09 : Certification of Venture Company
- 2017.02 : Certification of R&D Center
- 2017.04 : Developed Low-power BLE Chipset (SMIC, 50nm)
- 2017.05 : Received BLE 4.0 Protocol Stack Bluetooth SIG Certificate, first in Korea
- 2017.08 : Started the Design Service Business with Samsung Electronics
- 2018.10 : Design partner (VDP) contract with Samsung Electronics
- ~Current : Providing SoC design & verification service for SEC FDS & SystemLSI

3. Business

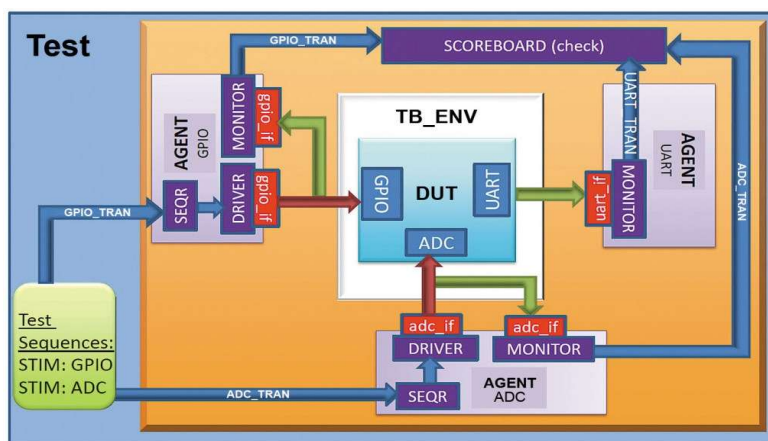
■ SoC/Chipset/MCU Design Service

- ✓ ARM Cortex M/A/R series based SoC Architecture/Platform Development
- ✓ AP SoC Integration Design (IPXACT/Magillem Based)
- ✓ Meridian CDC/Spyglass DFT/Lint(IPXACT, RTL, DC)/VCLP/UPF/Synthesis/SDC
- ✓ Various IP Design (Video/Audio/Display/Bus Component/Algorithms)



■ SoC/Chipset/MCU Verification Service

- ✓ UVM/System Verilog Based Verification
- ✓ Scenario based Testbench & Test code development
- ✓ Main/Local Bus Verification based on IWB environment (Cadence)
- ✓ Performance Verification (PV) based on IWB environment (Cadence)
 - : Bandwidth Analysis/Peak Performance Analysis/QoS Analysis etc
- ✓ AP SoC BLK/AP System Component/Digital IP/Analog IP Verification



■ PDK Development

- ✓ PDK development project with SEC Foundry

※ 채용담당자 : 조아라 대리/ 070-4211-8996/ arjo@conextt.com

12

(주) 텔레칩스

Telechips

www.telechips.com

LIMITLESS, MOVING FORWARD TO SDV

Telechips는 미래 모빌리티 산업의 변화를 주도하는
글로벌 팹리스 반도체 기업입니다.

JOIN US!

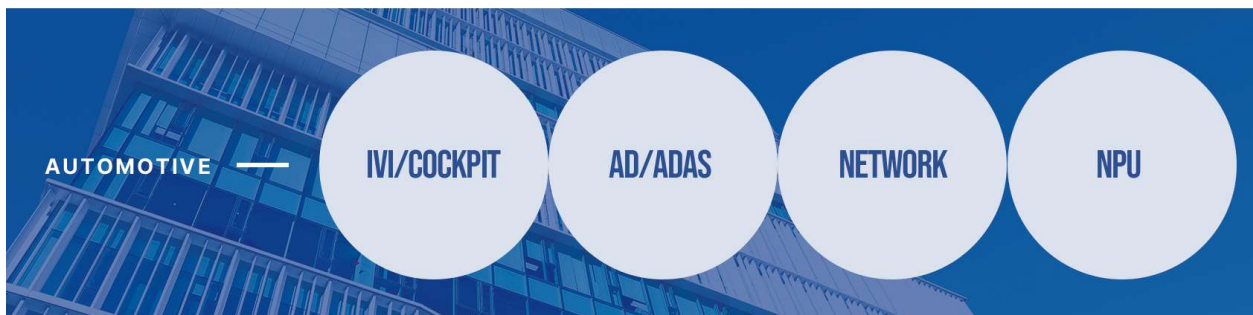


Telechips

Connect Innovative Values and Provide Newness

Telechips는 모빌리티 산업의 미래를 주도하고 있습니다.

인포테인먼트 AP뿐만 아니라 MCU, ADAS, 네트워크 게이트웨이, AI 가속기 등 글로벌 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.



소중한 인재를 모십니다.

미래 디지털 라이프 기술을 선도하는 텔레칩스에서는 가장 혁신적인 경험을 할 수 있습니다.

AD/ADAS

Embedded SW

SoC

System HW

Platform SW

PM

AE/FAE

Sales & Marketing

생산관리

품질검증

연구기획/관리

TOPST

How We Work

텔레칩스는 도전과 협력에 집중할 수 있는 업무문화를 가지고 있습니다.

완전 자율 출퇴근 문화

개인 업무에 따라 스스로 출퇴근 시간을 결정

직급이 없는 문화

나이나 연차에 관계없이 실력과 역량으로 인정

아낌없이 지원하는 문화

구성원의 성장과 몰입을 돕는 다양한 베테핏

Benefits

함께하는 동료들을 위해 최고의 복지를 제공합니다.

Work/Life Balance	리프레시 휴가 (연 5일) / 장기근속 휴가 및 휴가비 / 휴양지 프리미엄 콘도 지원
Health & Well-being	종합건강검진 지원 (가족 포함) / EAP(근로자 심리지원 프로그램) / 사내 피트니스 센터 (PT 지원)
Financial Benefits	1일 3식 전체 지원 / 사원대여금 운영 / 사택 지원 / 통근버스 운영 / 단체보험 지원
Family Life	각종 경조사 지원 / 가정의 달 행사·금액 지원 / Mother Box / 자녀 입학 축하금 지원
Personal Development	E-Learning 콘텐츠 지원 / 전화외국어 지원 (가족 포함) / 자유로운 스터디그룹 지원
Fun Office Life	사옥 내 밴드합주실, 노래방, 플레이스테이션 존 운영, 사내동호회 지원, 호프데이 등 각종 이벤트

'텔레칩스 채용' 홈페이지에서 간편하게 지원하세요!

careers.telechips.com

recruit@telechips.com (문의사항)

회사명	(주)퓨처디자인시스템 (Future Design Systems)		
주소	대전시 유성구 유성대로 593, 대덕테크비즈센터 504호		
홈페이지	http://www.future-ds.com	https://github.com/github-fds	
설립일	2017.05.17	구성원	4명 (대표이사 포함)
대표자	기안도 (Ando Ki)	연락처	adki@future-ds.com / 010-3843-6937
비전	계산가속으로 세상의 문제들을 빠르게 해결하여 산업발전과 인류복지에 기여한다.		
시장	동형암호와 인공지능 (암호화된 데이터를 복호화 없이 연산할 수 있는 기술) - Outsourcing Computation - Privately - Anonymous data processing - Short-term identity - Genomics, Health, National Security, Education, Social security, Business analytics, Cloud computing		
기술	재설정가능반도체 활용 하드웨어 가속 CPU 동형암호/인공지능 프로그램 GPU Hotspots FPGA ASIC		동형암호 프로그램/응용 개발 동형암호 알고리즘 핫스팟 분석 고성능/대용량 FPGA 보드 설계 동형암호 응용프로그램 API 개발 동형암호 연산자 구현 고속/고성능 호스트 인터페이스 설계 (PCIe) INTT/INTT Reduction tCRT/CRT Rounder 고속/대용량 메모리 시스템 설계 (DDR, HBM) mod ADD mod MUL 디바이스 드라이버 개발 FPGA PCIe Gen4, x8~x16 lane Server PC

제품현황	High-end for server computer  http://www.future-ds.com/en/products.html#DeepAccel-DualVU9P	Mid-range for desktop PC  http://www.future-ds.com/en/products.html#DeepAccel	Low-end for single-board computer  http://www.future-ds.com/en/products.html#CON_FMC
------	--	---	---

※ 채용담당자 : 서성원 이사/ 042-864-0211/ swseo@future-ds.com

기업 소개

저희 하이딤은 2010년에 설립된 Fabless design 회사이며 2022년 코스닥 상장사입니다.

On-cell Flexible OLED 디스플레이를 사용하는 Premium 레벨의 Global 스마트폰, 스마트워치, 태블릿 제품을 목표 시장으로 합니다. 연간 약 18.8 억대 규모의 거대 시장이고, 2024년 스마트폰용으로만 약 8억대가 적용 예상되는 OLED 디스플레이에 대한 혁신적인 Touch 및 Stylus용 플랫폼 솔루션을 개발하고 있습니다.

현재 글로벌 Top-tier 모바일기기 제조사들과 디스플레이 제조사들과 Co-work 하여 Touch와 Stylus 지원용 IC를 디자인하며, 제품 적용을 위한 알고리즘, 센서, 스타일러스 뿐 아니라 UI/UX까지 타 Fabless design 회사들과는 달리 분명한 차별성을 가지는 독자 기술 솔루션을 확보하기 위해 필요한 전체 기술을 개발하는데 역량을 집중하고 있고 이외 기술 분야를 넓혀 나가기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

2014년 1mm conductive stylus 기술을 최초로 Lenovo 태블릿 모델 등에서 상용화 성공하였고, 2015년 Apple 보다 먼저 3D Force Touch 기술을 Huawei 스마트폰 모델들에 적용시켜 양산 성공하였으며, 2021년 On-cell flexible OLED 디스플레이를 적용 시작한 Samsung의 스마트워치에서 안정적인 터치 기술을 양산 성공하였습니다. 그리고 또 한번 세상에 없던 기술 솔루션 개발을 진행하고 있습니다.

전 세계 대상으로 최고의 기술 경쟁력 확보가 하이딤의 변함없는 최우선 목표입니다.

하이딤의 인재상

긍정적이고 열정적인 자세, 문제 해결에 대한 적극적인 자세, 평범한 일상에 안주하지 않고 끊임없는 성장을 원하는 분.

하이딥?

국가대표 반도체IC 설계회사

세상에 없던.

가능하리라 상상하지 않았던.

누구도 성공하지 못한.

비밀병기 설계 중.

지금 탑승하세요.



내가 설계한 IC가 수천만개 양산되어
세계 프리미엄 제품들에 탑재되는 짜릿한 경험을 드립니다.



구분	모집 부문	자격 요건
연구소	Software Engineer	• C / C++ / C# programming 가능자 • Algorithm / Firmware programming 가능자
	Analog IC Designer	• Analog IP 설계 가능자
	Digital IC Designer	• VLSI / SOC / Memory 설계 가능자
	Hardware Engineer	• 회로이론 및 전자공학에 대한 기본적인 이해
	Layout Engineer	• Analog layout, Digital P&R 가능자
	공통	공정적이고 열정적인 자세, 문제 해결에 대한 적극적인 자세 명확한 일상에 맞추어지고 끊임없는 성장을 원하는 분
지원자격	전자공학 및 관련 전공자, 학사/석사 졸업생(경력자도 가능), 졸업예정자 병역특례: 전문연구요원 대상자(석사이상), 사회복무요원 소집대상자(학사)	
접수	이력서 email 접수: mariana.kim@hideep.com www.hideep.com	

※ 채용담당자 : 김경영 부장/ 031-717-5775/ mariana.kim@hideep.com

회사 개요

반도체 센서 IC개발 전문 기업 해치텍

· 회사명	주식회사 해치텍
· CEO	최 성 민
· 설립일	2017.02.08
· 사업	반도체 제조
· 소재지	(청주 본사) 오창읍 연구단지로 40 (서울사무실) 강남구 선릉로 112길,85
· 임직원	38명
· 매출액	114억 (2023년)

주요 제품

센서 및 복합 알고리즘 기반 맞춤형 솔루션 제공



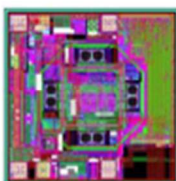
40년 이상의 시스템 반도체 및 자기센서 개발 역량 보유

아날로그 회로 설계

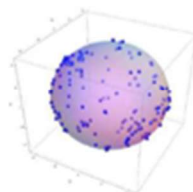
자기장 신호 처리 솔루션

안정화된 공정기술

대규모 테스트 및 보정 기술



- Offset Cancellation
- Low Noise Amplifier
- 16bit Analog-Digital Converter



- Magnetometer Accelerometer
- Gyroscope Integral Calibration(MAGIC)
- 9D(6D)-Fusion Algorithm & Calibration



- Hall element & IMC
- Tiny WLCSP(0.8mm x 0.8mm)



- High Precision Magnetic Field Generation Probe Card
- X, Y, Z 3-axis offset calibration

주요 고객사

글로벌 고객 다변화에 따른 안정적 매출 실현 및 시장 점유율 증대



복리후생

임직원의 열정과 성과에 보답하는 기업

주거 지원

- 임직원 주택 구입·전세금 대출
- 기숙사 지원 (청주 근무)

금전적 지원

- 경영 인센티브·스톡옵션
- DC형 퇴직연금 가입·운용
- 시간 외 근로수당
- 중식비 별도 지원

교육

- 직무교육 지원
- 학위 취득 지원 (석·박사)

가족 친화

- 경조사 지원 (휴가 및 경조금)
- 자녀 축하금 지급 (입학·졸업)
- 명절·기념일 선물 지급
- 종합검진 혜택 (배우자 포함)
- 임직원 실손보험 가입

기타

- 간식/커피 무제한 제공 (Cafeteria)
- 워크숍 행사 (1회/연)

채용 정보

성장과 미래를 함께 만들어 갈 인재를 기다립니다.

모집 분야	직무
Analog design	Sensor IC AFE 설계
Digital design	Verilog RTL 설계
주요 업무 및 역량	

Analog design

- Analog block 설계
 - LDO, BGR, Amplifier, ADC, Oscillator, POR
 - I/O ESD 회로
- 사용 tool
 - Spectre, MMSIM, Virtuoso (schematic/layout)

Digital design

- Verilog RTL coding & verification
 - Interface logic, Timing control logic
 - 연산 algorithm logic
- Test plan & test setup

☐ 채용 문의: 송미화 차장 / mihwa.song@haechechtech.com / +82-10-9989-9602



반도체설계교육센터
IC DESIGN EDUCATION CENTER

academy.idec.or.kr
www.idec.or.kr

